

# 真空ソルダリングシステム

## Model:SQ1 仕様

| 仕様     | SQ1                           |
|--------|-------------------------------|
| チャンバ数  | 1チャンバ(加熱&冷却)                  |
| 装置サイズ  | 約W1000 x D750 x H1300 約450kg  |
| 処理スペース | W300 x D300 x H100 (12inch対応) |
| 加熱方式   | IRヒーター 加熱温度 MAX.400°C         |
| 冷却方式   | 水冷プレート                        |
| 真空ポンプ  | 耐食型ドライポンプ 真空到達度 20Pa以下        |
| 排気処理   | ギ酸分解処理ユニット搭載                  |

# Vacuum Reflow Soldering System

## Model: SQ1 Specification

| Specification     | SQ1  |
|-------------------|--|
| Number of chamber | 1(Heating & Cooling)                       |
| Dimensions (mm)   | W1000 x D750 x H1300 (450kg)               |
| Process area (mm) | W300 x D300 x H100 (12inch)                |
| Heating           | IR heaters Temperature up to 400°C         |
| Cooling           | Water-cooled plate                         |
| Vacuum pump       | Corrosion-proof type dry pump 20Pa or less |
| Exhaust treatment | Formic acid decomposition unit             |